

高速解析

## ウエハー内部クラック検査装置

短時間検査



注) AIイメージ

### 概要

本装置は、半導体ウェハノッチ部分の内部クラックをSWIRカメラを用いて検査します。SWIRカメラは一般的に0.9~1.7 $\mu\text{m}$ の波長帯を撮影できるカメラのことを指します。私たちが触れる機会の多いカメラは主に可視光(0.4~0.7 $\mu\text{m}$ )の波長帯を撮影するため、私たちの目には見えない情報を撮影できます。SWIR帯域に高い感度を持つInGaAs(ヒ化インジウムガリウム)センサーが一般的に使用されています。検査結果を自動でデータ保存・自動判定(良品/不良)が可能で自動で不良発生時アラート出力も可能です。検査後の商品は、品質保証が可能になります。手載せの手動機から、24時間対応の全自動機まで対応させていただきます。

### 装置構成例

構成(回転機構部含む) スケーラーOP。

1. 1/1.4インチカメラ
2. テレセントリックレンズ
3. スポット光源:電源含む
4.  $\theta$ ステージ 回転角度360度
5. 回転筐体
6. カメラ照明台
7. 画像処理用パソコン:モニター
8. 緊急停止ボタン

### 装置仕様

- |          |                        |
|----------|------------------------|
| ・カメラ     | SWIRカメラ                |
| ・レンズ     | テレセントリック倍率2倍           |
| ・照明      | SWIR LEDライト            |
| ・照明電源    | PCによるUSB制御             |
| (画像部)    |                        |
| ・視野サイズ   | 約4.48mm×3.36mm         |
| ・画像合成機能  | X、Y軸及び回転               |
| ・画素分解能   | 約1.6 $\mu\text{m}$ /画素 |
| ・CAD比較検査 | オプション                  |

### 測定検査例

